

聯茂電子

2026年第三季投資人簡報

ITEQ

INNOVATION. TEAMWORK. EXCELLENCE. QUALITY

Nov 2026

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



ITEQ

INNOVATION · TEAMWORK ·
EXCELLENCE · QUALITY

公司簡介

成立日期
1997年4月10日

總部
臺灣新竹縣

實收資本額
NT$ 36.3億

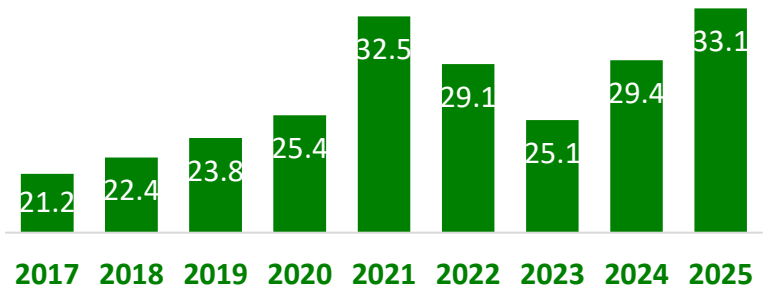
員工
約4,000人

董事長
陳進財

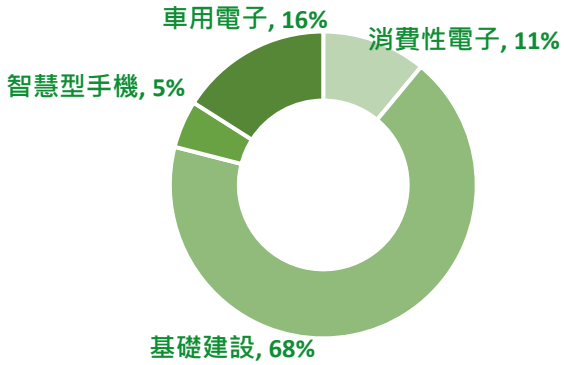
執行長
蔡馨曄

主要產品
銅箔基板 (CCL) & 膠片 (PP) | 多層壓合代工 | 軟性銅箔基板

營收 (NT$ 十億元)



產品應用別營收 (2025全年)



關鍵技術應用

ITEQ

基礎建設
資料中心
雲端運算
AI/5G基礎建設

智慧型手機
平板

Controlled Dk and Low Df

FR-4 Halogen Free

Low Dk Ultrathin

High Reliability

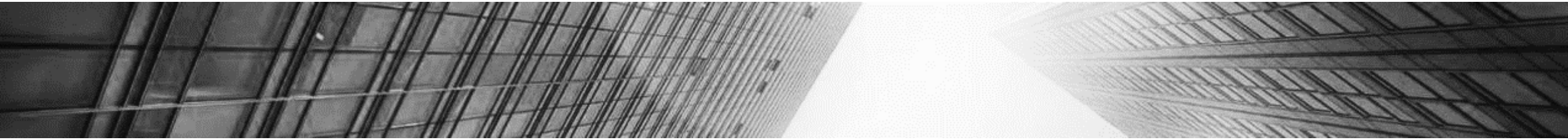
材料科學

樹脂配方

精密製程

消費性電子

車用電子



成長策略藍圖

ITEQ

技術創新之路

ITEQ

廣泛應用於消費性
電子產品







導入車用銅箔基板於
知名國際廠商



提供智慧型手機應
用之銅箔基板



提供伺服器應用之
銅箔基板



成為Intel Purley伺
服器平台主要銅箔
基板供應商





台灣最大5G基地台
應用之銅箔基板供應
商



新產品發表：背膠銅箔
(RCC)



AI應用高速材料

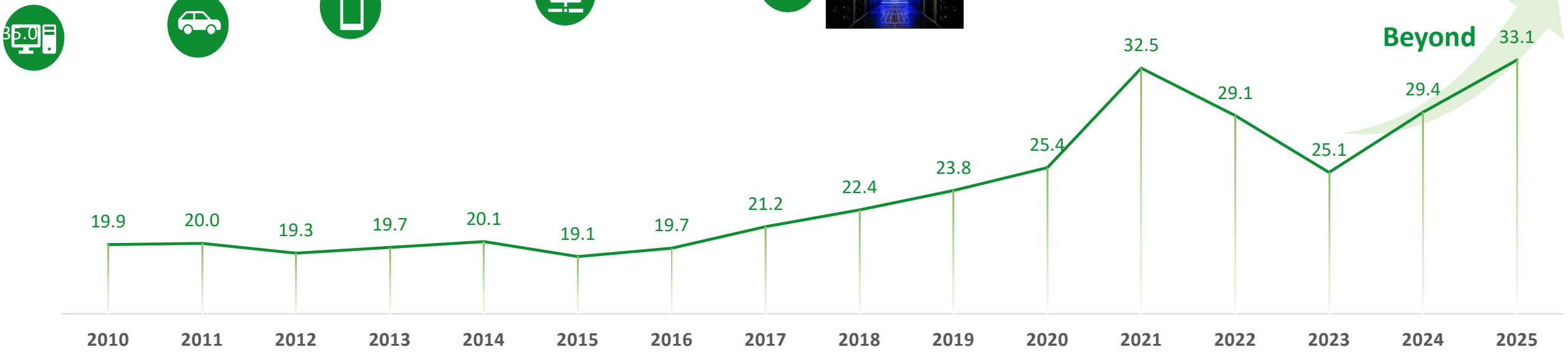
AI



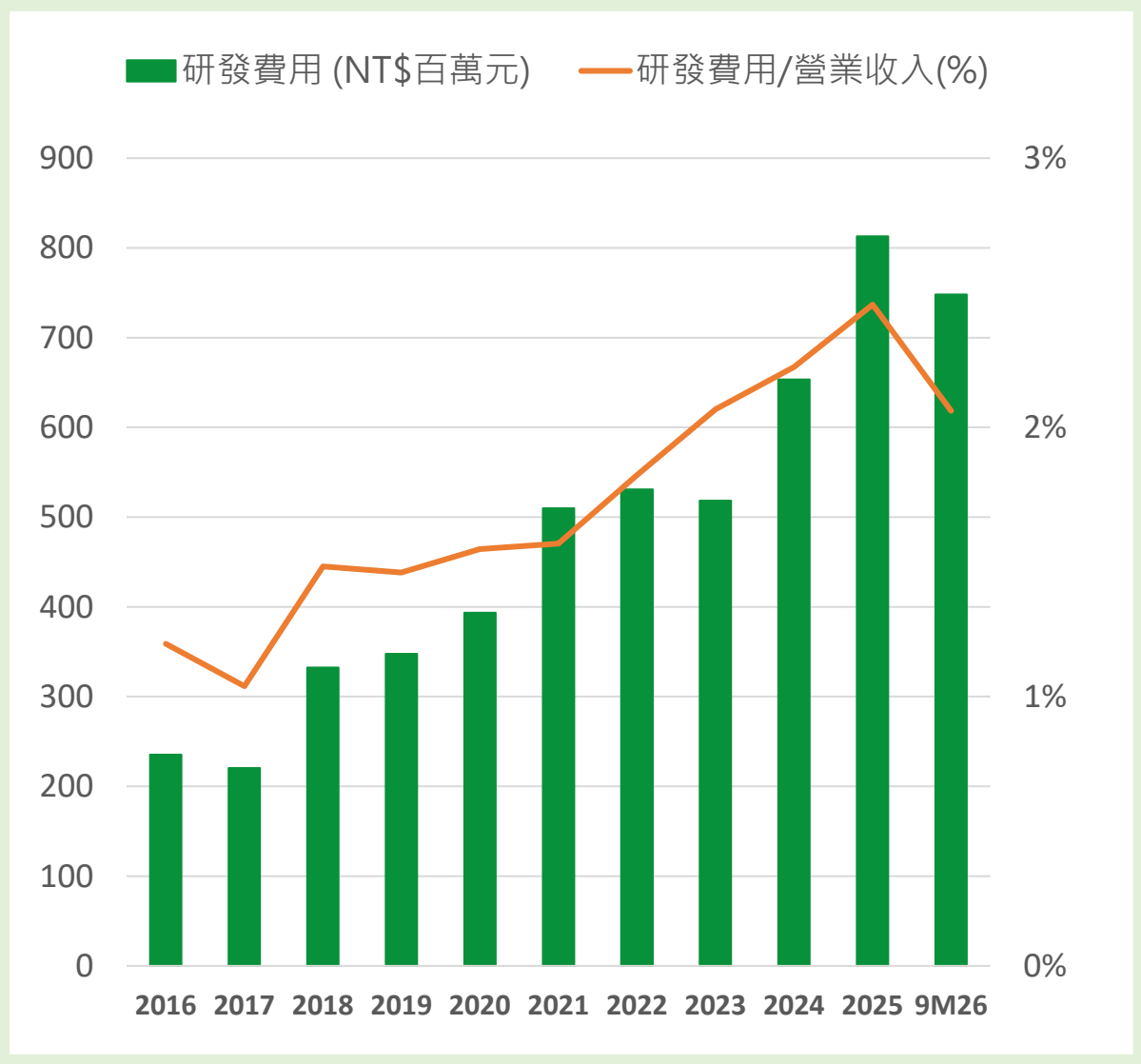
低軌衛星應用

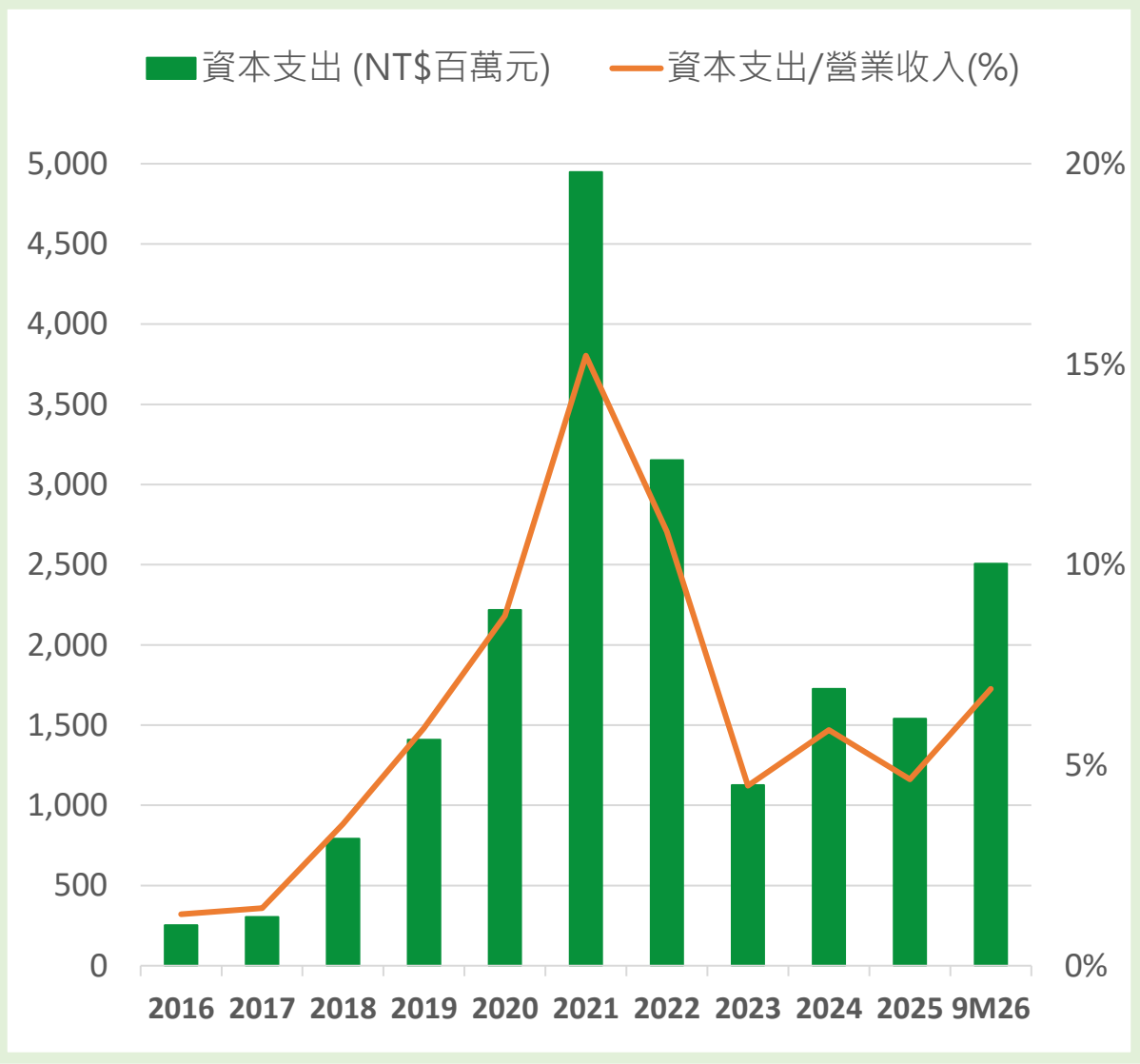
LEO





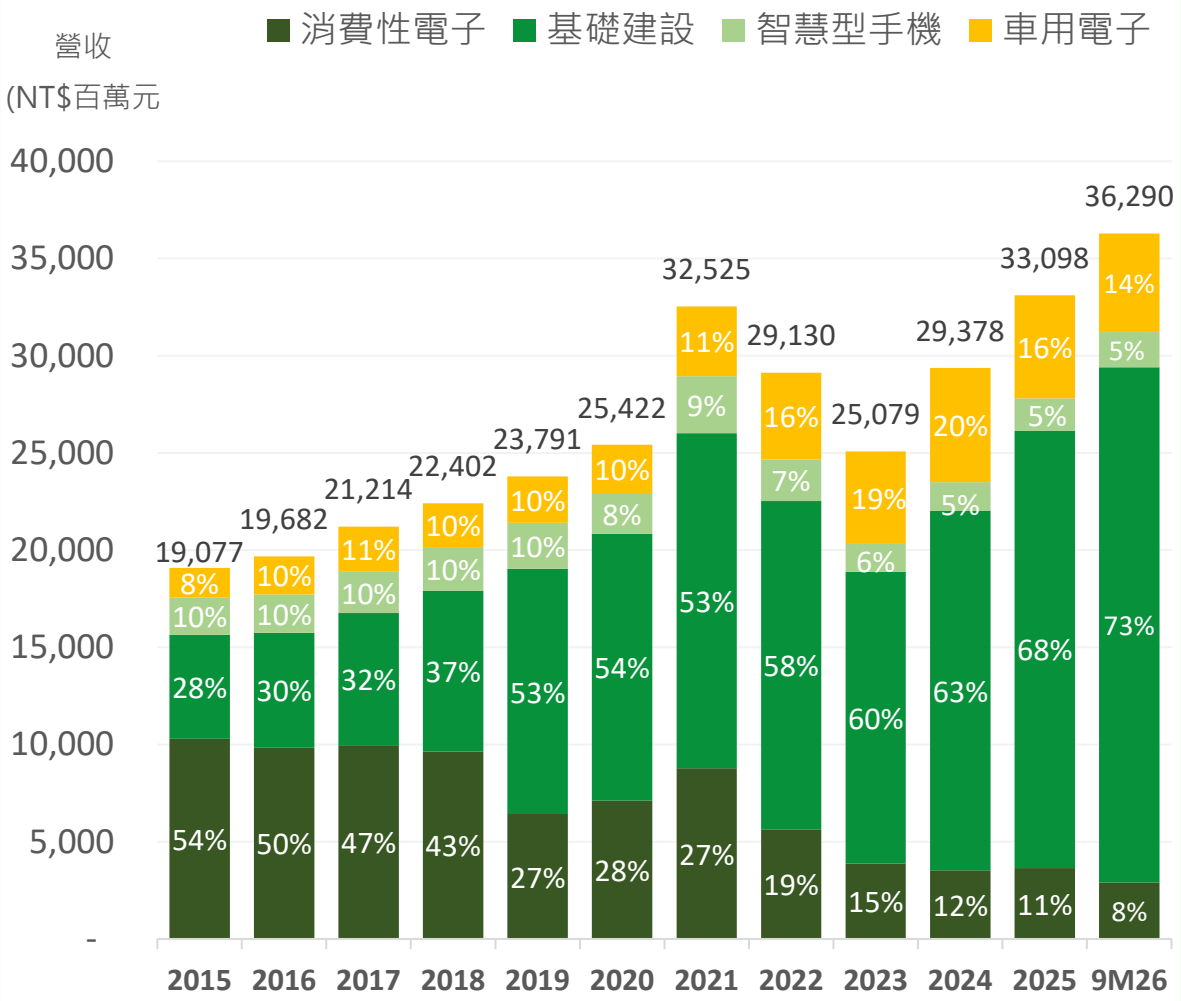
永續成長 - 投入研發與資本支出

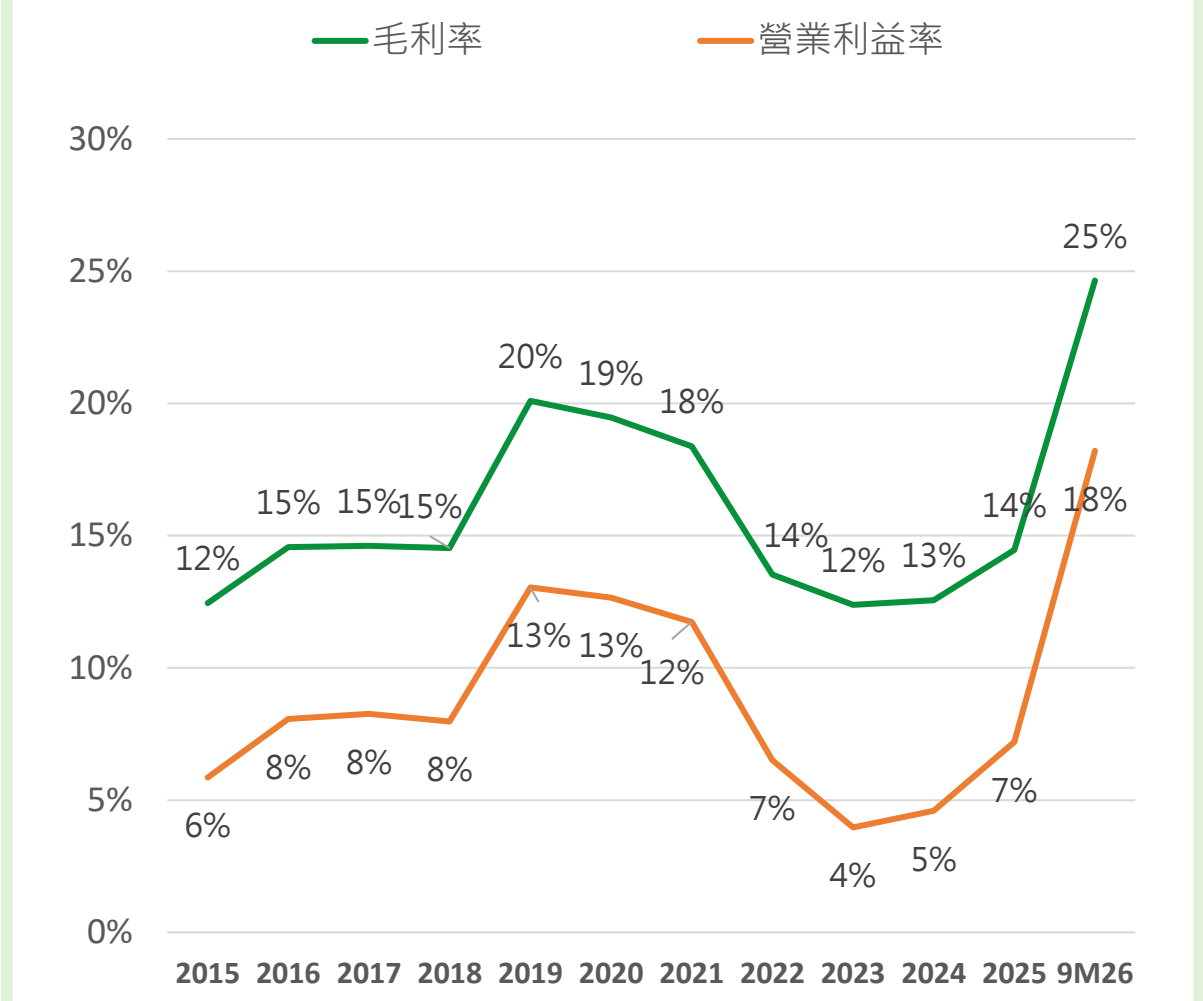




*9M26資本支出包含預付設備款增加約NT$24.39億元

創新帶動產品組合優化

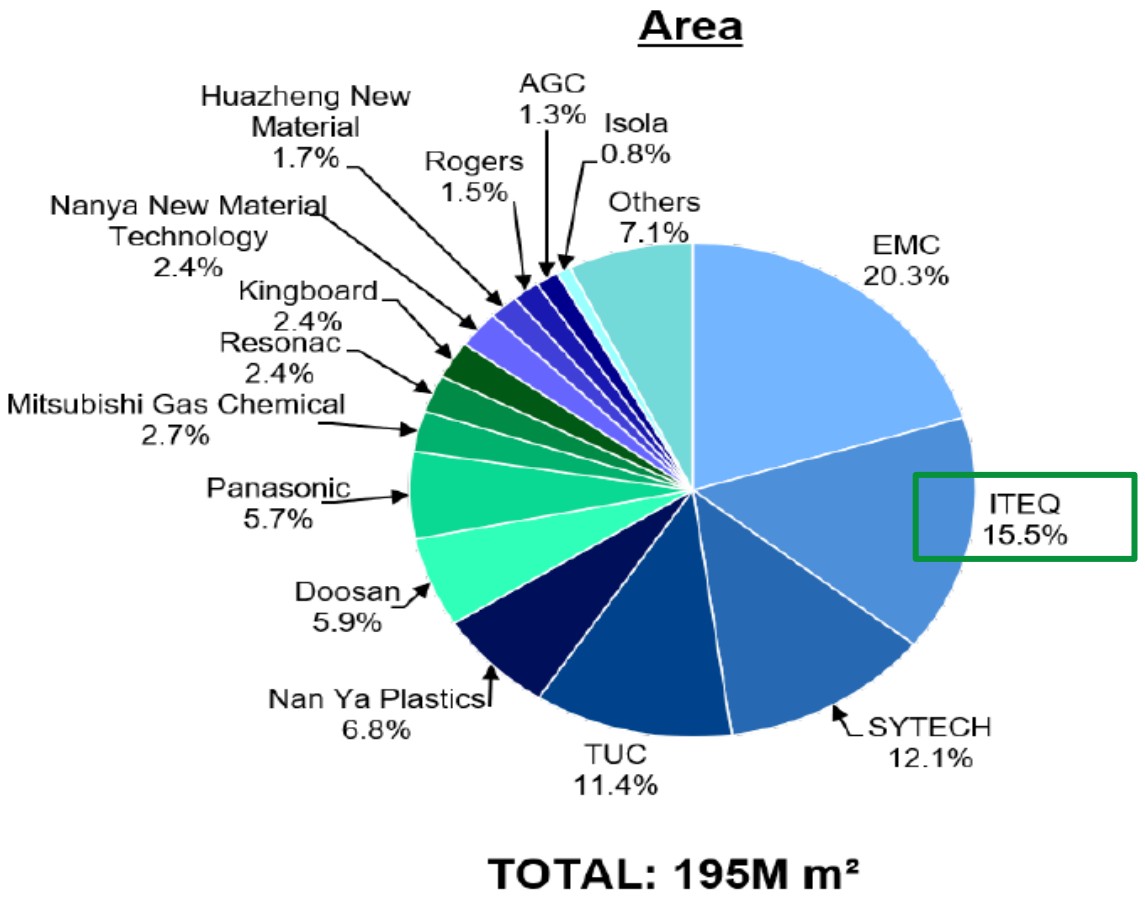

營收
(NT$百萬元
消費性電子
基礎建設
智慧型手機
車用電子
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
19,077
19,682
21,214
22,402
23,791
25,422
32,525
29,130
25,079
29,378
33,098
36,290
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
9M26


毛利率
營業利益率
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
9M26

全球特殊基板領航者

ITEQ

2025年全球特殊基板供應商市佔率



*特殊基板包含：高速基板、封裝基板、射頻基板

資料來源：Prismark Report, 2026/06

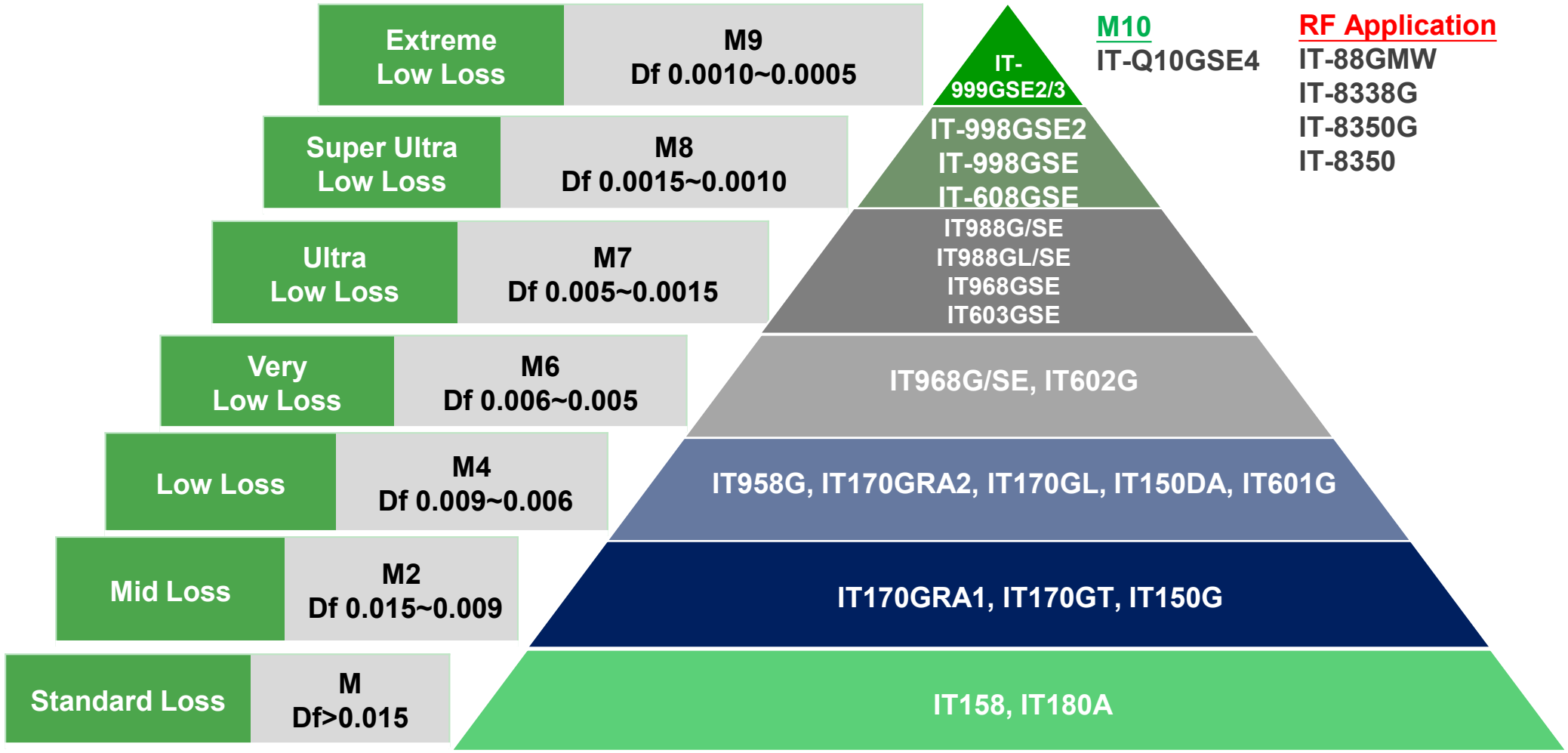
聯茂：銅箔基板領先供應商

- 全球高速高頻銅箔基板主要供應商
- 先進製程技術和豐富量產經驗
- 網通基礎建設與高速運算資料中心升級商機之長期受惠者
- 全球車市電氣化趨勢擴大車用電子對高速高頻材料需求

ITEQ

INNOVATION · TEAMWORK · EXCELLENCE · QUALITY

完整的產品線規劃

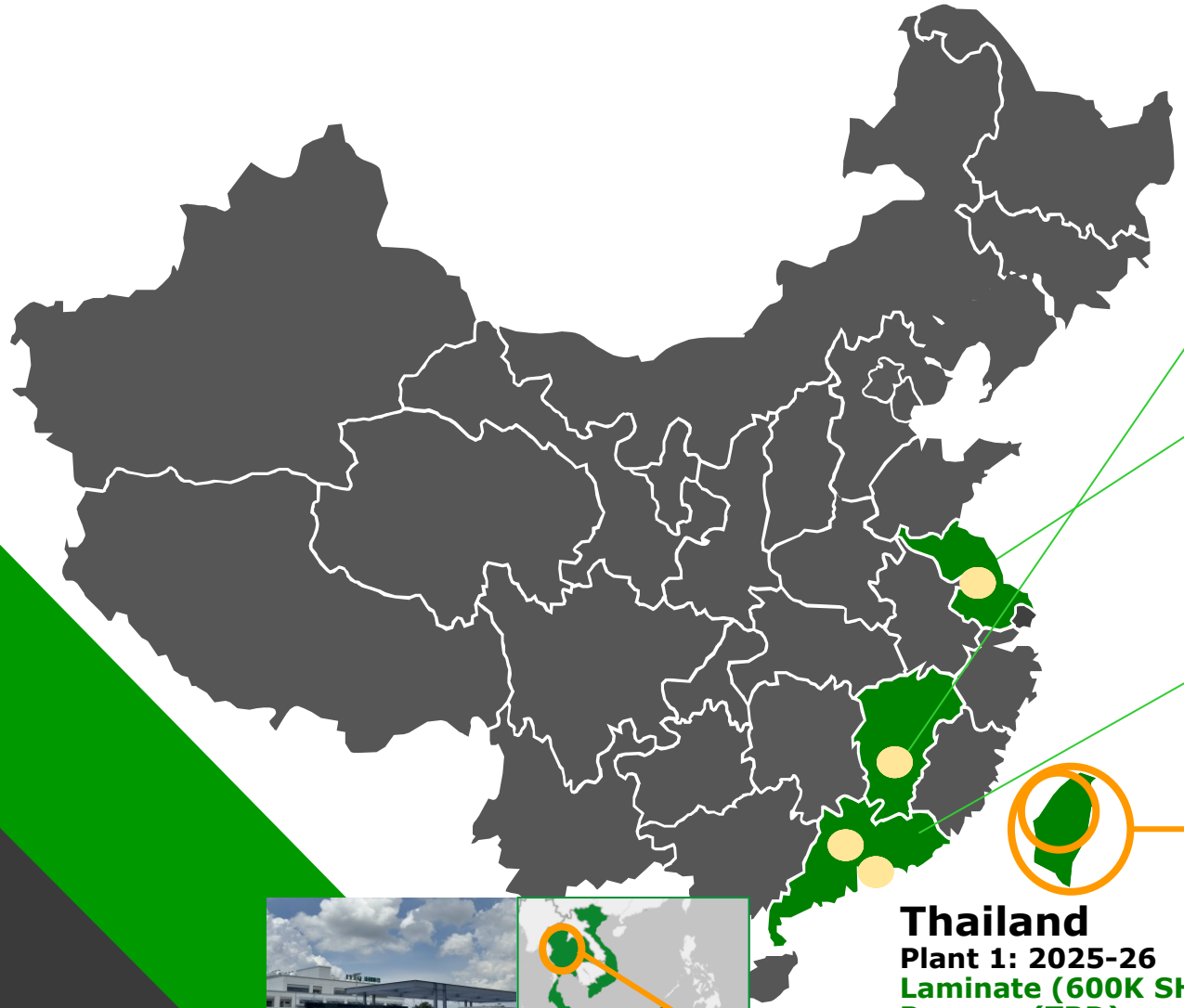


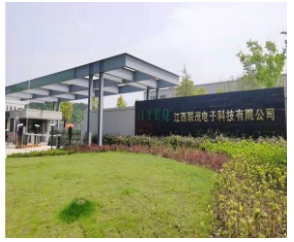
- 隨著高速運算資料中心、AI伺服器升級等需求，帶動高頻高速材料需求高度成長。
- ITEQ在高頻高速材料市場的市占率將顯著提升。

廠區分布與產能 – 擴產

ITEQ

Distributor/Agent: USA, Europe, Israel, Korea, Japan and Singapore





JiangXi Plant
Since 2019
Laminate (2,400K SHT/Month)
Prepreg (6,000K M² /Month)



WuXi Plant
Laminate (1,650K SHT/Month)
Prepreq (4,000K M² /Month)
New Plant: 2027-29
Laminate (2,850K SHT/Month)
Prepreq (TBD)



DongGuan Plant
Laminate (450K SHT/Month)
Prepreq (1,500K M² /Month)



GuangZhou Plant
FCCL (1,150K M²/Month)



HsinChu (Headquarters)
Laminate (600K SHT/Month)
Prepreg (1,500K M/Month)

Thailand
Plant 1: 2025-26
Laminate (600K SHT/Month)
Prepreg (TBD)
Plant 2: 2028
Laminate (600K SHT/Month)
Prepreg (TBD)

銅箔基板產能規劃

ITEQ

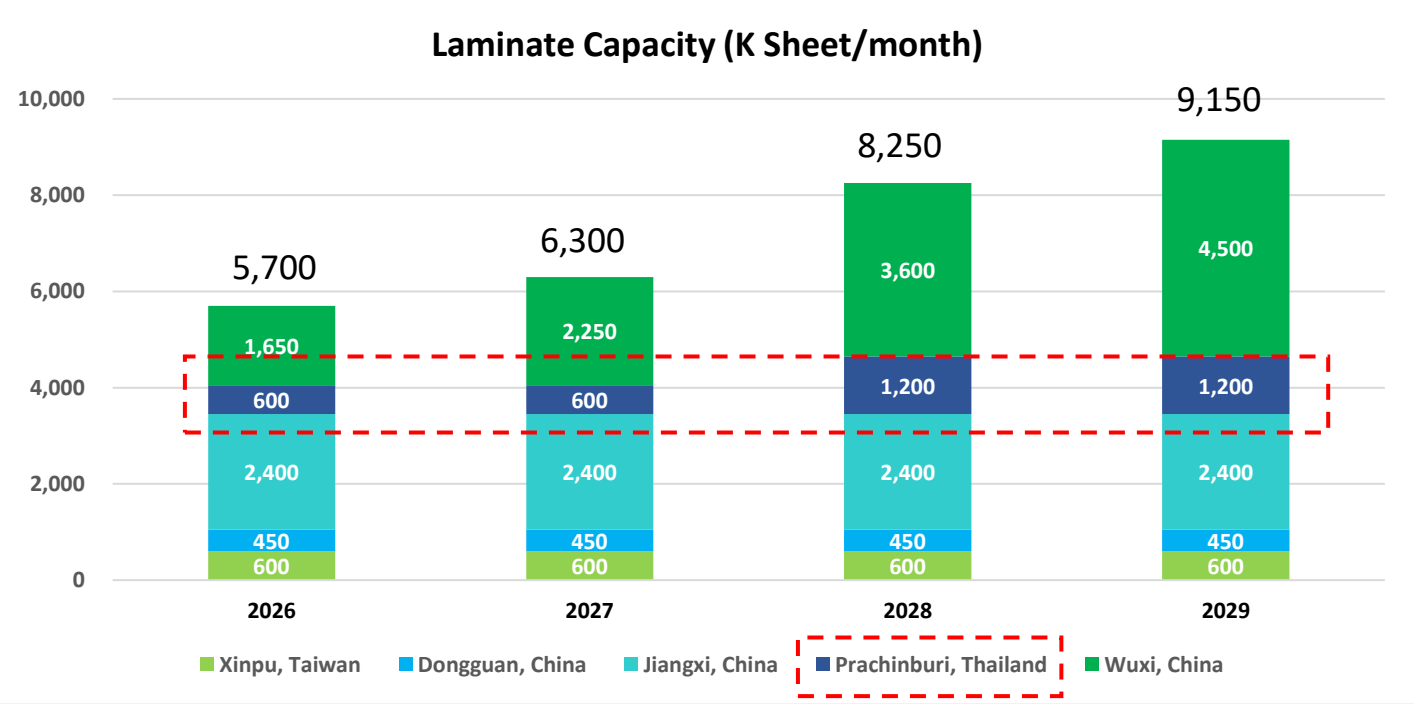
2026 Expansion in Thailand

2027 Expansion in East China

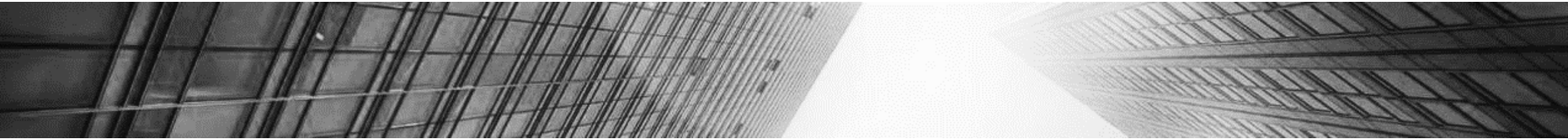
2028 Expansion in Thailand & East China

2029 Expansion in East China

2030 Monthly capacity 9.15 million sheets







市場趨勢 & 成長動能

ITEQ

伺服器CPU平台持續升級

ITEQ

Intel	Platform	Purley		Whitley	Eagle Stream		Birch Stream	Oak Stream
	CPU	Skylake	Cascade Lake	Ice lake	Sapphire Rapids	Emerald Rapids	Granite Rapids	Diamond Rapids
	Nano Process	14 nm	14 nm+	10 nm	Intel 7	Intel 7	Intel 3	Intel 18A
	PCIe Gen	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 6.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	2021 Q1	2023 H1	2023 H2	2024	2026
	CCL Material	Mid Loss	Mid Loss	Low Loss	Very Low Loss	Very Low Loss	VLL/ Ultra Low Loss	Ultra Low Loss
	Layer count	8 to 12	8 to 12	12 to 16	16 to 20	16 to 20	18 to 22	20 to 24
AMD	Architecture	Zen	Zen2	Zen3	Zen4		Zen5	Zen6
	CPU	Naples	Rome	Milan	Genoa	Bergamo	Turin	Venice
	Nano Process	14 nm (Global Foundries)	7 nm (TSMC)	7 nm (TSMC)	5 nm (TSMC)	5 nm (TSMC)	4 nm / 3 nm (TSMC)	2 nm (TSMC)
	PCIe Gen	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 6.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	2020 Q4	2022 Q4	2023	2024	2026
	CCL Material	Mid Loss	Low Loss	Low Loss	Very Low Loss	Very Low Loss	VLL/ Ultra Low Loss	Ultra Low Loss
	Layer count	8 to 12	12 to 16	12 to 16	16 to 20	16 to 20	18 to 22	20 to 24







資料中心長期穩定升級將有利予以下；

- 對應設備之基板材料亦同等升規
- 增加銅箔基板消耗量與設計板層數

新能源車用電子商機

ITEQ

綠能/電動車



- 節能
- 充電
- 大電流
- 大電壓
- 厚銅

High Tg 材料

車聯網

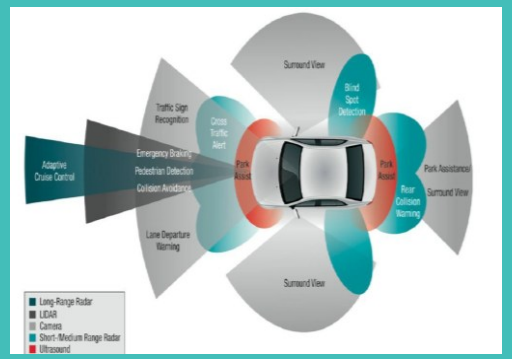


- 車用資訊娛樂
- 網路通訊

HDI 材料

高速材料

主動式安全系統



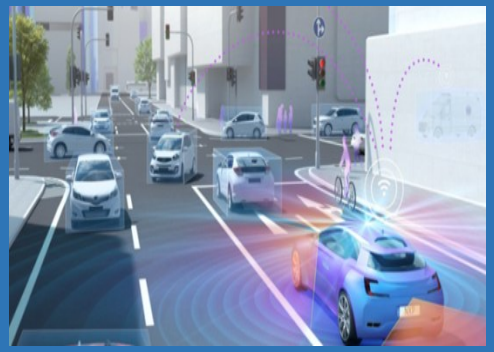
- 安全駕駛系統
- ADAS (先進駕駛輔助系統)
- 雷達
- 天線模組

HDI 材料

高速材料

高頻材料

自動駕駛

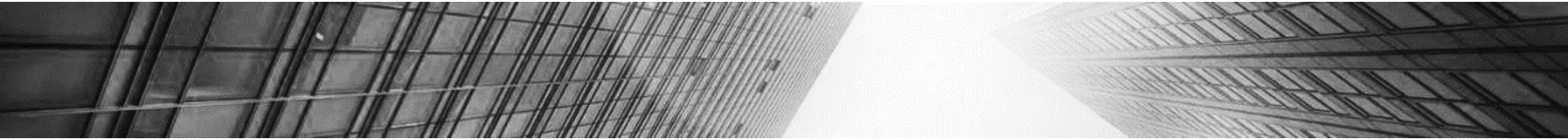


- 車用高速運算
- 影像處理計算
- 自主駕駛控制平台模組

HDI 材料

高速材料

- 電動車、車聯網和主動式安全駕駛系統將推動高性能車用銅箔基板之需求
- 電動車用PCB為傳統燃油車的四至五倍



3Q26 營運成果

ITEQ

3Q26 損益表

ITEQ

NTD/百萬元	3Q26	2Q26	3Q25	QoQ	YoY
營業收入	**15,617**	**11,530**	**7,724**	**35.4%**	**102.2%**
營業毛利	5,361	2,539	1,061	111.1%	405.3%
營業費用	1,026	691	615	48.5%	66.8%
營業利益	**4,334**	**1,848**	**446**	**134.5%**	**871.7%**
營業外收入及支出	2	(14)	75		
稅前淨利	4,336	1,834	521	136.4%	732.2%
所得稅費用	1,278	555	196		
歸屬於母公司之淨利	3,058	1,279	325	139.1%	840.9%
每股盈餘(NTD)	**8.41**	**3.52**	**0.89**	**138.9%**	**844.9%**
重要財務比率					
毛利率	**34.33%**	**22.02%**	**13.74%**		
營業費用率	6.57%	5.99%	7.96%		
營業利益率	**27.75%**	**16.03%**	**5.77%**		
有效稅率	29.47%	30.26%	37.62%		
淨利率	**19.58%**	**11.09%**	**4.21%**		

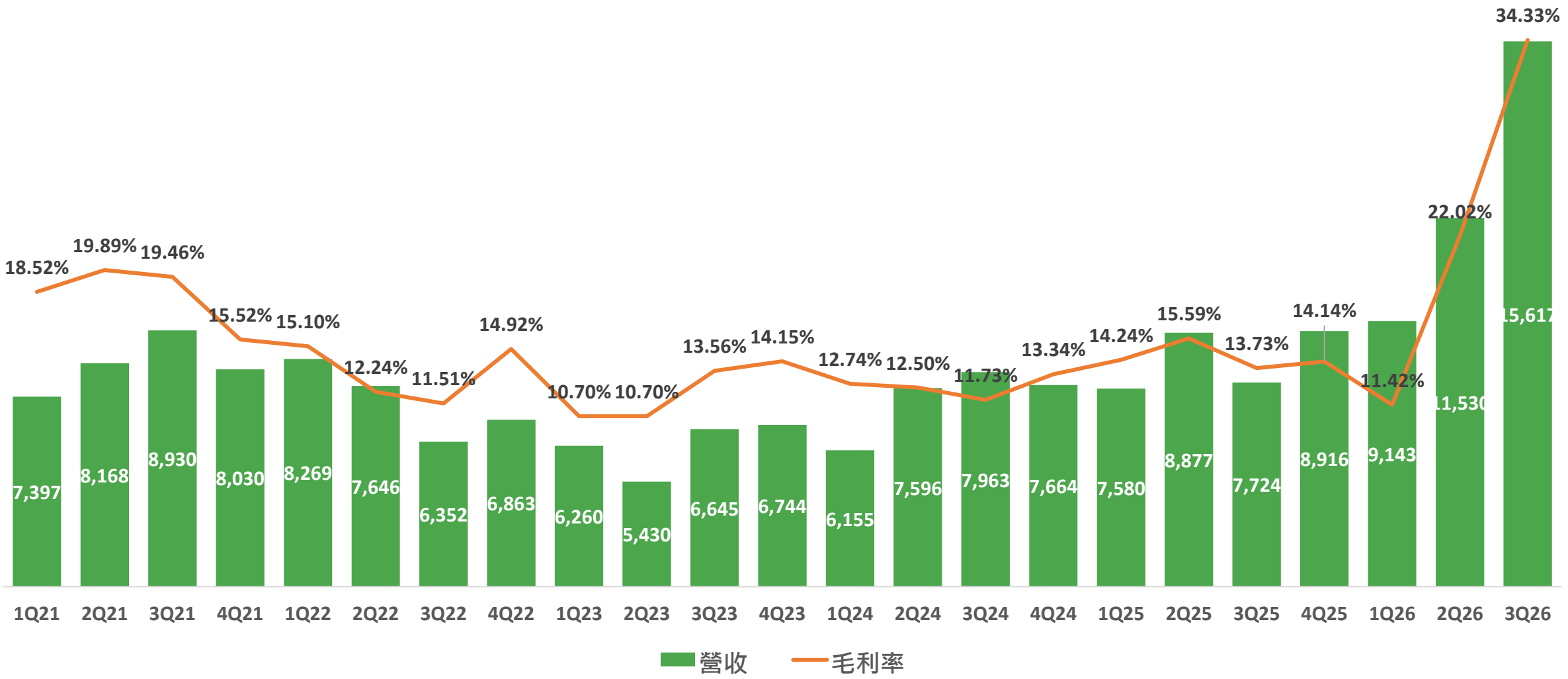
3Q26 資產負債表

ITEQ

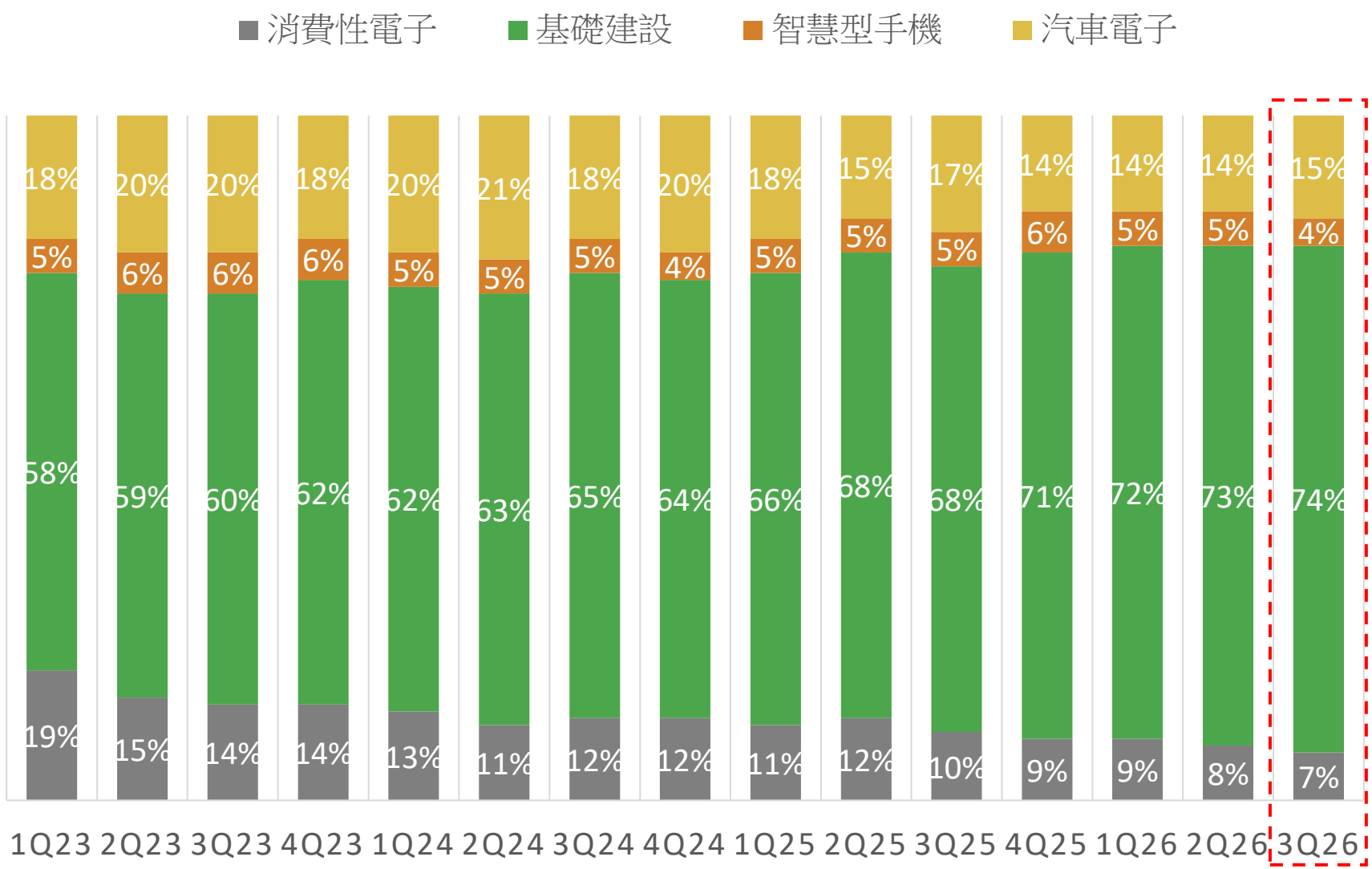
NTD/百萬元	3Q26	2Q26	3Q25
資產總額	**51,678**	**43,290**	**34,734**
現金及約當現金	3,799	2,822	4,541
應收帳款/票據	24,406	18,622	13,344
存貨	8,887	7,261	4,298
固定資產	10,333	8,797	9,183
負債總額	**25,778**	**20,696**	**14,999**
短期借款	6,811	4,564	3,451
應付帳款/票據	11,604	10,662	7,451
長期借款	2,377	1,431	1,756
股東權益總額	**25,900**	**22,594**	**19,735**
重要財務指標			
應收帳款週轉天數	159	164	150
存貨週轉天數	76	76	60
應付帳款週轉天數	107	113	91.83
股東權益報酬率(年化)(%)	21.5	10.70	6.4
資產報酬率(%)	11.49	5.98	4.13
負債比(%)	49.9	47.81	43.2

營收 & 毛利率

(百萬 NTD)


18.52%
19.89%
19.46%
15.52%
15.10%
12.24%
11.51%
14.92%
10.70%
10.70%
13.56%
14.15%
12.74%
12.50%
11.73%
13.34%
14.24%
15.59%
13.73%
14.14%
11.42%
22.02%
34.33%
7,397
8,168
8,930
8,030
8,269
7,646
6,352
6,863
6,260
5,430
6,645
6,744
6,155
7,596
7,963
7,664
7,580
8,877
7,724
8,916
9,143
11,530
15,617
1Q21
2Q21
3Q21
4Q21
1Q22
2Q22
3Q22
4Q22
1Q23
2Q23
3Q23
4Q23
1Q24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
3Q25
4Q25
1Q26
2Q26
3Q26
營收
毛利率

產品組合

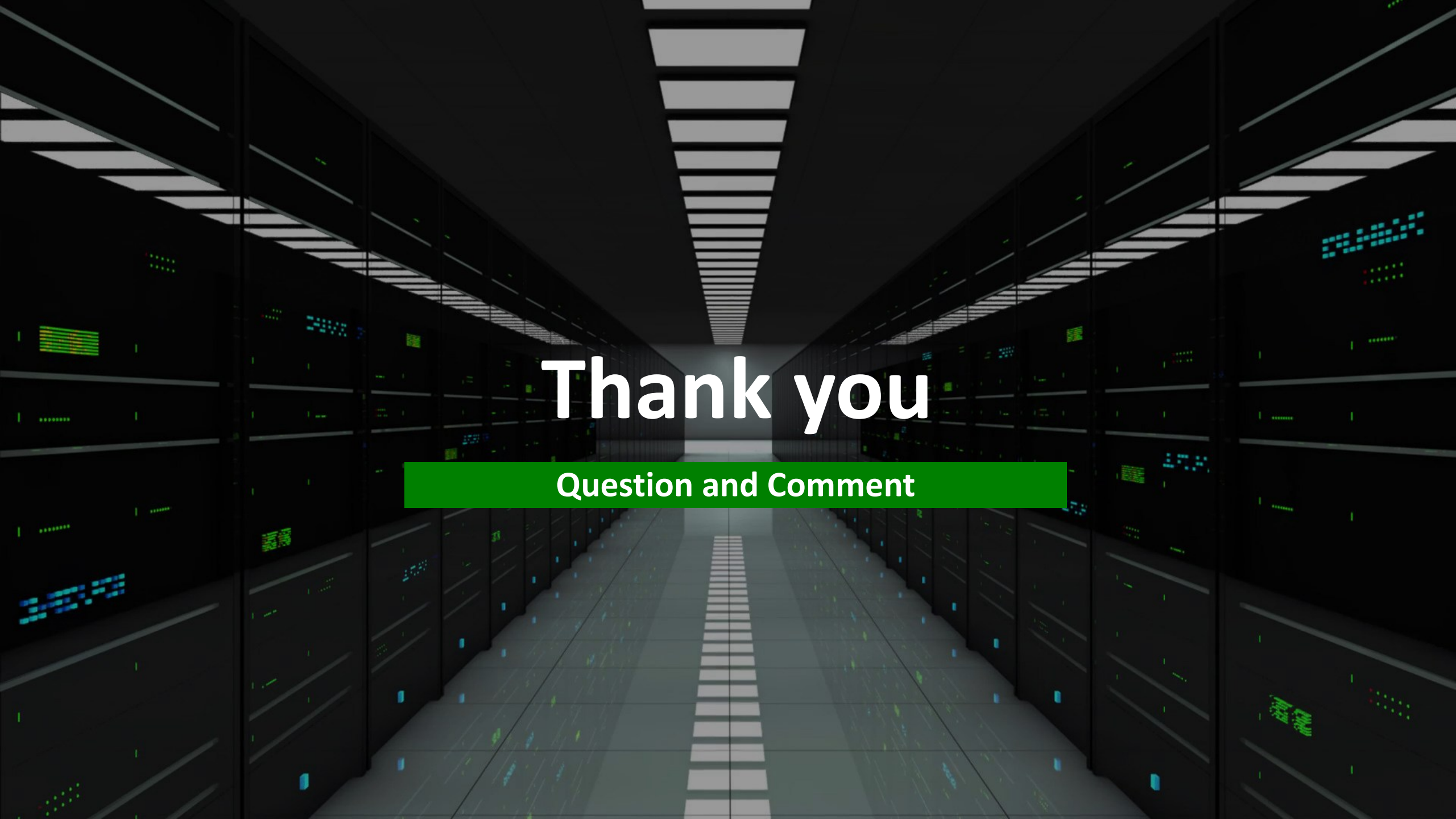


3Q26 產品成長率	QoQ	YoY
汽車電子	45.1%	78.4%
智慧型手機	8.4%	61.8%
基礎建設	37.3%	120.0%
消費性電子	18.5%	41.5%

配息政策

年度	每股盈餘(NT$)	股利(NT$)	現金股利(NT$)	配息率(%)
2019	8.13	5.0	5.0	62%
2020	8.19	5.0	5.0	61%
2021	9.00	5.0	5.0	56%
2022	4.94	3.0	3.0	61%
2023	1.86	1.5	1.5	81%
2024	2.26	1.8	1.8	80%
2025	4.16	3.0	3.0	72%

*於2020年3月31日完成現金增資發行新股3千萬股
**於2021年9月2日完成現金增資發行新股5千萬股
***計入3Q22庫藏股買回與註銷2千萬股；目前普通股數約為3.63億股


Thank you
Question and Comment

補充附錄

ITEQ

銅箔基板 & 膠片製造流程

核心技術(一)：材料科學

樹酯　催化劑　硬化劑

核心技術(二)：
樹酯配方

配方

玻纖布

上膠

膠片(PP)

銅箔

銅箔基板(CCL)

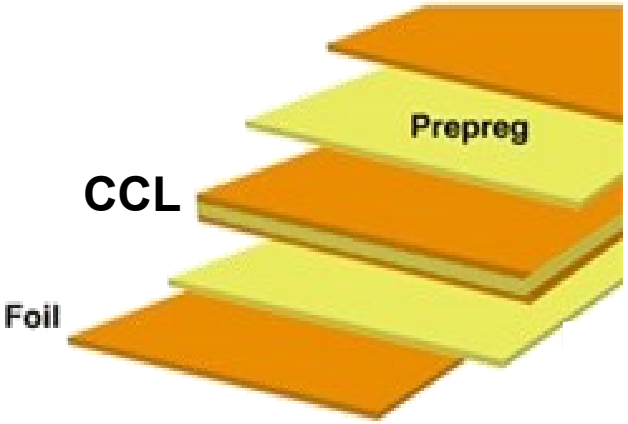
裁切　堆疊　壓合　檢測

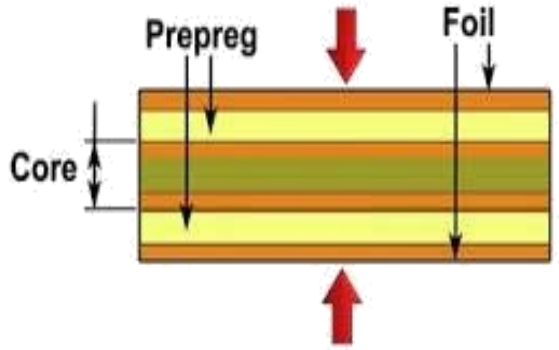
核心技術(三)：製程優化

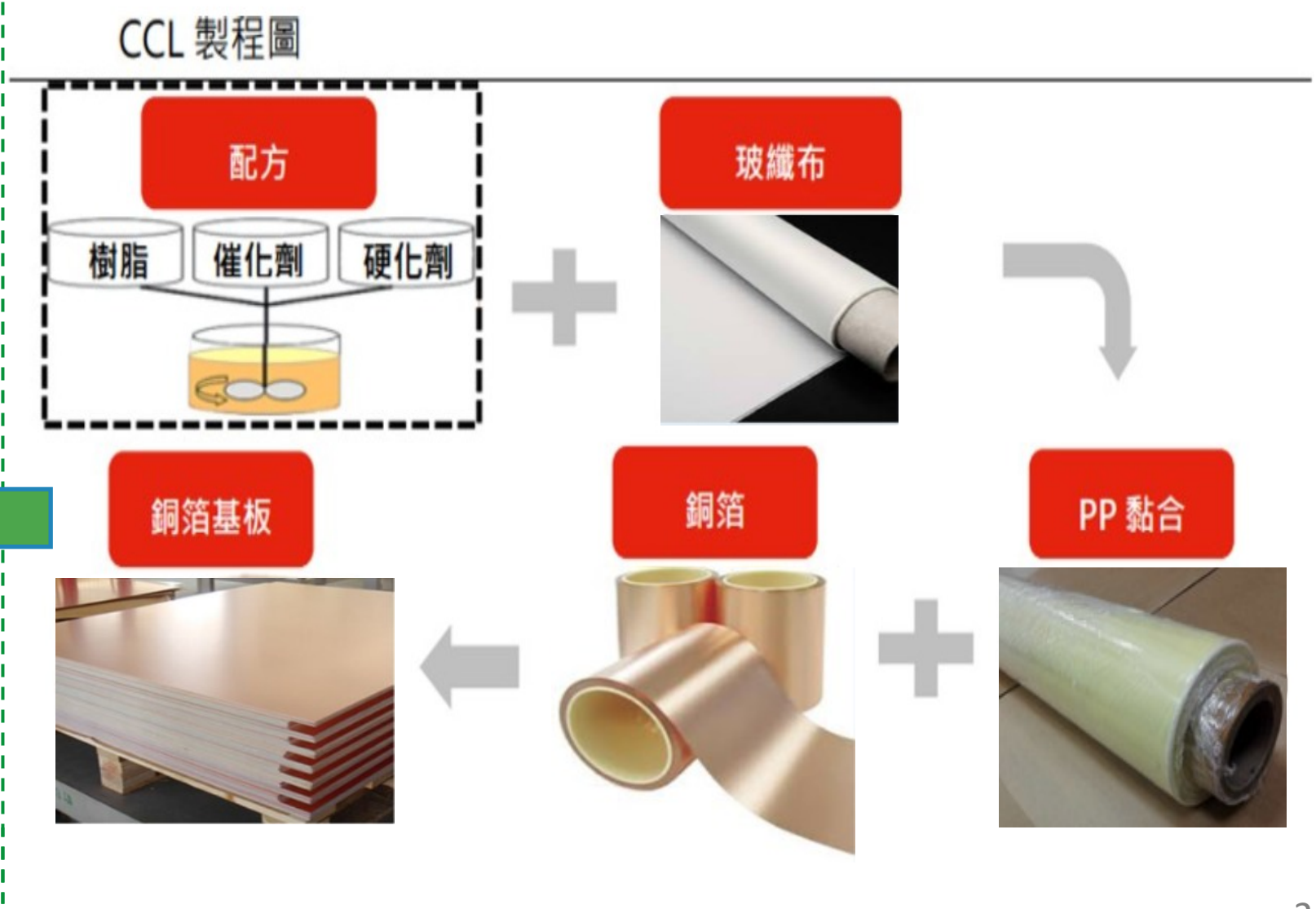
銅箔基板/膠片組成結構

ITEQ

CCL/PP







AI伺服器需求推升CCL產值

ITEQ

AI伺服器CPU*2主板
(產值-中)

(Used in both general type server and AI server)

CPU主板

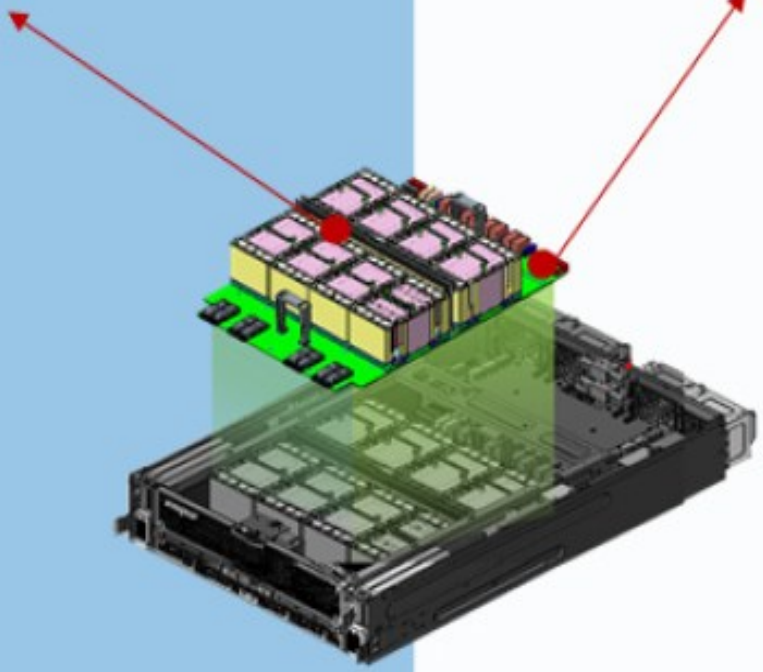


CCL：Very Low Loss 材料
板層數：14~24層

AI伺服器GPU OAM加速卡*8
(產值-高)

(Used in accelerator card– AI server only)

GPU Tray



CCL：Very Low Loss 材料
板層數：20~30層 (HDI)

AI伺服器GPU UBB底板
(產值-高)

(Used as GPU board– AI server only)

CCL：Ultra Low Loss / VLL 材料
板層數：20~30層 (含HDI)